



2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕（連結）

2024年7月31日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社アドバンテスト

コード番号 6857 URL <https://www.advantest.com/ja/investors/>

代表者 (役職名) 代表取締役兼経営執行役員社長 Group C00 (氏名) 津久井 幸一

問合せ先責任者 (役職名) 経営執行役員 CFO&CSO (氏名) 三橋 靖夫 TEL 03-3214-7500

配当支払開始予定日 -

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無：有

(百万円未満四捨五入)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績（2024年4月1日～2024年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		税引前利益		四半期利益		親会社の所有者に帰属する四半期利益		四半期包括利益合計額	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	138,725	37.0	31,325	119.5	31,930	146.3	23,873	159.4	23,873	159.4	38,541	43.7
2024年3月期第1四半期	101,251	△25.5	14,269	△68.1	12,961	△73.2	9,202	△74.8	9,202	△74.8	26,828	△41.8

	基本的1株当たり 四半期利益	希薄化後1株当たり 四半期利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	32.35	32.25
2024年3月期第1四半期	12.49	12.44

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「基本的1株当たり四半期利益」および「希薄化後1株当たり四半期利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	資産合計	資本合計	親会社の所有者に 帰属する持分	親会社所有者 帰属持分比率
	百万円	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	723,230	456,934	456,934	63.2
2024年3月期	671,229	431,178	431,178	64.2

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	-	65.00	-	18.00	-
2025年3月期	-	-	-	-	-
2025年3月期（予想）	-	19.00	-	-	-

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

詳細については、本日公表の「中間配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の第2四半期末については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2024年3月期の年間配当については、株式分割の実施により単純合算ができないため、表示しておりません。なお、株式分割を考慮しない場合の年間配当金は137円、株式分割を考慮する場合の年間配当金は34.25円です。

3. 2025年3月期の連結業績予想（2024年4月1日～2025年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		税引前利益		当期利益		親会社の所有者に 帰属する当期利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
通期	600,000	23.3	138,000	69.1	138,500	77.2	105,000	68.6	105,000	68.6

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

詳細については、添付P.4「(4) 今後の見通し」および本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更：無

② ①以外の会計方針の変更：無

③ 会計上の見積りの変更：無

（3）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2025年3月期1Q	766,141,256株	2024年3月期	766,141,256株
2025年3月期1Q	27,723,631株	2024年3月期	27,729,675株
2025年3月期1Q	738,005,962株	2024年3月期1Q	736,909,016株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

（注）1. 期中平均株式数は、株式報酬制度に係る株式を考慮して計算しております。

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期中平均株式数」を算定しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本短信には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	P. 2
(1) 経営成績の概況	P. 2
(2) 財政状態の概況	P. 3
(3) キャッシュ・フローの概況	P. 3
(4) 今後の見通し	P. 4
2. 要約四半期連結財務諸表および主な注記	P. 5
(1) 要約四半期連結財政状態計算書	P. 5
(2) 要約四半期連結損益計算書および要約四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 要約四半期連結持分変動計算書	P. 7
(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 8
(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 9
(継続企業の前提に関する注記)	P. 9
(セグメント情報)	P. 9
2024年度第1四半期決算(連結)の概要	P. 11

1. 経営成績等の概況

(1) 経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間(2024年4月1日~2024年6月30日)の状況 (単位:億円)

	2024年3月期 第1四半期連結累計期間	2025年3月期 第1四半期連結累計期間	前年同期比
売上高	1,013	1,387	37.0%
営業利益	143	313	2.2倍
税引前四半期利益	130	319	2.5倍
四半期利益	92	239	2.6倍

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、根強いインフレを背景に金融引き締め政策が継続したものの、全体としては底堅く推移しました。

このような世界経済情勢のもと、半導体市場は前年同期の調整局面から一転して回復傾向となりました。その中でも、データセンタ向けのHPCデバイスや、HBMなどの高性能DRAMといった、生成AIの普及に関連する半導体の需要が大きく伸びました。一方、自動車や産業機器向け半導体などは軟調に推移したことで、半導体全体としての需要の回復はまだらな様相を呈しました。

当社グループの半導体試験装置ビジネスにおいては、高性能半導体向けでの顧客の旺盛な設備投資を背景に、当社グループ製品の販売が前年同期比で大きく伸長しました。

これらの結果、売上高は1,387億円(前年同期比37.0%増)となりました。円安を含めた増収効果に加え、製品ミックスの変化もあり、営業利益は313億円(同2.2倍)、税引前四半期利益は319億円(同2.5倍)、四半期利益は239億円(同2.6倍)となりました。当四半期の平均為替レートは、米ドルが153円(前年同期135円)、ユーロが165円(同146円)、海外売上比率は96.2%(前年同期95.8%)でした。

セグメントの業績は次のとおりであります。

<半導体・部品テストシステム事業部門> (単位:億円)

	2024年3月期 第1四半期連結累計期間	2025年3月期 第1四半期連結累計期間	前年同期比
売上高	705	1,011	43.3%
セグメント利益(△損失)	183	325	77.3%

当部門では、SoC半導体用試験装置は、HPCデバイスやアプリケーション・プロセッサでの性能向上を背景に、先端プロセス品向けの売上が大幅に増加しました。一方で自動車や産業機器関連などの成熟半導体向けでの需要が軟調であることから、当社グループの関連する製品についても売上が減少しました。メモリ半導体用試験装置については、HBMをはじめとする高性能DRAMに向けた旺盛な試験装置需要を背景に売上が伸長しました。

以上により、当部門の売上高は1,011億円(前年同期比43.3%増)、セグメント利益は325億円(同77.3%増)となりました。

<メカトロニクス関連事業部門>

(単位：億円)

	2024年3月期 第1四半期連結累計期間	2025年3月期 第1四半期連結累計期間	前年同期比
売上高	85	143	66.9%
セグメント利益(△損失)	0	25	—

当部門では、半導体試験装置に対する顧客の旺盛な需要を背景に、関連するデバイス・インタフェースの売上が伸長しました。ナノテクノロジー関連の売上も増加しました。

以上により、当部門の売上高は143億円(前年同期比66.9%増)、セグメント利益は25億円(同25億円増)となりました。

<サービス他部門>

(単位：億円)

	2024年3月期 第1四半期連結累計期間	2025年3月期 第1四半期連結累計期間	前年同期比
売上高	222	234	5.4%
セグメント利益(△損失)	△6	14	—

当部門では、当社グループ製品の設置台数の増加に伴いサポート・サービスの売上は伸長しました。他方で、システムレベルテストにおいては、特定顧客向けの売上比率が高い製品の需要が軟調のため、売上が減少しました。売上ミックスの変動により、当セグメントの収益が改善しました。

以上により、当部門の売上高は234億円(前年同期比5.4%増)、セグメント利益は14億円(同20億円改善)となりました。

(2) 財政状態の概況

当第1四半期末の総資産は、棚卸資産が139億円、営業債権およびその他の債権が99億円、のれんおよび無形資産が99億円、現金および現金同等物が87億円、それぞれ増加したことなどにより、前年度末比520億円増加の7,232億円となりました。負債合計は、未払法人所得税が91億円、営業債務およびその他の債務が84億円、それぞれ増加したことなどにより、前年度末比262億円増加の2,663億円となりました。また、資本合計は4,569億円となり、親会社所有者帰属持分比率は前年度末比1.0ポイント減少の63.2%となりました。

(3) キャッシュ・フローの概況

当第1四半期末における現金および現金同等物は、前年度末より87億円増加し、1,154億円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益319億円を計上したことに加え、棚卸資産の増加(△115億円)、営業債権およびその他の債権の増加(△76億円)、営業債務およびその他の債務の増加(67億円)に減価償却費などの非資金項目等の損益を調整した結果、277億円の収入(前年同期は、39億円の支出)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、84億円の支出(前年同期は、133億円の支出)となりました。これは主に、子会社の取得による支出(△39億円)、有形固定資産の取得による支出(△38億円)によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、146億円の支出(前年同期は、68億円の収入)となりました。これは主に、配当金の支払額(△130億円)とリース負債の返済による支出(△14億円)によるものであります。

(4) 今後の見通し

今後の当社グループを取り巻く事業環境を展望しますと、暦年2024年は半導体需給の改善が期待されるとともに、生成AI関連の投資の活発化から、半導体市場は成長軌道に回帰することが予想されます。半導体試験装置市場においても、生成AIに向けた半導体の需要の高まりに連動して、関連する半導体試験装置需要の顕著な増加が見込まれます。具体的には高性能DRAMに向けた旺盛な試験装置需要に加え、S o C半導体用試験装置においても複雑性の増加がテスト需要を想定よりも急峻なペースで引き上げています。その一方で、自動車や産業機器に向けた試験装置の需要回復には時間を要すると見込みます。全体としては、暦年2024年の半導体試験装置市場は従前の見通しよりも強い需要の伸びを予想します。

これらの見通しおよび当第1四半期連結累計期間の業績進捗を踏まえ、当連結会計年度の通期連結業績予想を次のとおりに修正します。売上高は2024年4月時点の5,250億円から6,000億円へ、営業利益は900億円から1,380億円へ、税引前利益は890億円から1,385億円へ、当期利益は670億円から1,050億円へ、それぞれ上方修正します。予想の前提とした当連結会計年度第2四半期以降の9か月間の為替レートは、米ドルが140円、ユーロが155円です。なお、米国および同盟国による半導体製造装置の対中輸出規制に関し、現行法令において当連結会計年度の業績に対する直接的な影響は限定的と考えておりますが、引き続き今後の状況を注視してまいります。

中長期的には、半導体市場の拡大に加えて半導体の複雑性への対応が業界における構造課題となる中で、当社グループの事業機会は拡大するものと考えています。そうした環境下、当社グループは当連結会計年度を初年度とする第3期中期経営計画で掲げた施策を推し進め、中長期的なステークホルダーへの提供価値拡大に取り組んでまいります。

2. 要約四半期連結財務諸表および主な注記

(1) 要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産		
流動資産		
現金および現金同等物	106,702	115,402
営業債権およびその他の債権	88,855	98,720
棚卸資産	204,389	218,270
その他の流動資産	20,315	22,013
流動資産合計	420,261	454,405
非流動資産		
有形固定資産	78,884	81,819
使用権資産	19,106	19,938
のれんおよび無形資産	98,514	108,418
その他の金融資産	20,139	23,040
繰延税金資産	33,423	34,525
その他の非流動資産	902	1,085
非流動資産合計	250,968	268,825
資産合計	671,229	723,230
負債および資本		
負債		
流動負債		
営業債務およびその他の債務	76,863	85,225
未払法人所得税	10,262	19,315
引当金	8,668	8,670
リース負債	5,147	5,639
その他の金融負債	1,868	4,085
その他の流動負債	23,469	26,464
流動負債合計	126,277	149,398
非流動負債		
借入金	75,143	76,109
リース負債	14,153	14,514
退職給付に係る負債	19,134	19,873
繰延税金負債	3,934	3,579
その他の非流動負債	1,410	2,823
非流動負債合計	113,774	116,898
負債合計	240,051	266,296
資本		
資本金	32,363	32,363
資本剰余金	45,441	45,941
自己株式	△56,353	△56,334
利益剰余金	355,299	365,671
その他の資本の構成要素	54,428	69,293
親会社の所有者に帰属する持分合計	431,178	456,934
資本合計	431,178	456,934
負債および資本合計	671,229	723,230

(2) 要約四半期連結損益計算書および要約四半期連結包括利益計算書

(要約四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
売上高	101,251	138,725
売上原価	△50,300	△61,819
売上総利益	50,951	76,906
販売費および一般管理費	△36,903	△45,542
その他の収益	327	152
その他の費用	△106	△191
営業利益	14,269	31,325
金融収益	294	1,281
金融費用	△1,602	△676
税引前四半期利益	12,961	31,930
法人所得税費用	△3,759	△8,057
四半期利益	9,202	23,873
四半期利益の帰属 親会社の所有者	9,202	23,873
1株当たり四半期利益		
基本的	12.49円	32.35円
希薄化後	12.44円	32.25円

(要約四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期利益	9,202	23,873
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目		
確定給付制度の再測定	—	△197
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の公正価値の純変動	982	1,103
純損益に振り替えられる可能性のある項目		
在外営業活動体の換算差額	16,644	13,762
税引後その他の包括利益	17,626	14,668
四半期包括利益	26,828	38,541
四半期包括利益の帰属 親会社の所有者	26,828	38,541

(3) 要約四半期連結持分変動計算書

前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

(単位: 百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					合計	資本合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素		
2023年4月1日 残高	32,363	44,622	△59,099	319,171	31,637	368,694	368,694
四半期利益				9,202		9,202	9,202
その他の包括利益					17,626	17,626	17,626
四半期包括利益	—	—	—	9,202	17,626	26,828	26,828
自己株式の取得			△8			△8	△8
自己株式の処分		△961	1,983	△449		573	573
配当金				△12,895		△12,895	△12,895
株式に基づく報酬取引		431				431	431
所有者との取引額等合計	—	△530	1,975	△13,344	—	△11,899	△11,899
2023年6月30日 残高	32,363	44,092	△57,124	315,029	49,263	383,623	383,623

当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

(単位: 百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					合計	資本合計
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の資本の構成要素		
2024年4月1日 残高	32,363	45,441	△56,353	355,299	54,428	431,178	431,178
四半期利益				23,873		23,873	23,873
その他の包括利益					14,668	14,668	14,668
四半期包括利益	—	—	—	23,873	14,668	38,541	38,541
自己株式の取得			△3			△3	△3
自己株式の処分		△6	22	△13		3	3
配当金				△13,291		△13,291	△13,291
株式に基づく報酬取引		506				506	506
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替				△197	197	—	—
所有者との取引額等合計	—	500	19	△13,501	197	△12,785	△12,785
2024年6月30日 残高	32,363	45,941	△56,334	365,671	69,293	456,934	456,934

(4) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期利益	12,961	31,930
減価償却費および償却費	6,023	7,102
営業債権およびその他の債権の増減額 (△は増加)	39,099	△7,647
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△18,103	△11,511
営業債務およびその他の債務の増減額 (△は減少)	△19,783	6,738
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△214	△35
預り金の増減額 (△は減少)	1,712	2,055
前受金の増減額 (△は減少)	3,632	617
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△385	258
その他	△5,788	△428
小計	19,154	29,079
利息および配当金の受取額	264	471
利息の支払額	△352	△464
法人所得税の支払額	△23,013	△1,406
営業活動によるキャッシュ・フロー 計	△3,947	27,680
投資活動によるキャッシュ・フロー		
資本性金融商品の売却による収入	1,150	—
有形固定資産の取得による支出	△5,685	△3,778
無形資産の取得による支出	△144	△475
子会社の取得による支出	△8,311	△3,860
その他	△320	△239
投資活動によるキャッシュ・フロー 計	△13,310	△8,352
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	20,000	—
自己株式の処分による収入	542	3
配当金の支払額	△12,615	△12,975
リース負債の返済による支出	△1,162	△1,363
その他	△8	△253
財務活動によるキャッシュ・フロー 計	6,757	△14,588
現金および現金同等物に係る換算差額	3,836	3,960
現金および現金同等物の純増減額 (△は減少)	△6,664	8,700
現金および現金同等物の期首残高	85,537	106,702
現金および現金同等物の四半期末残高	78,873	115,402

(5) 要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

1. 報告セグメントの概要

当社グループは、半導体・部品テストシステム製品群とテスト・ハンドラやデバイス・インタフェース等のメカトロニクス関連製品群の製造・販売を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する研究開発および保守・サービス等の事業活動を展開しております。当社グループは3つの報告可能な事業セグメントを有しております。これらの報告可能な事業セグメントは、製品と市場の性質に基づいて決定され、経営者が経営意思決定のために使用する財務情報と同様の基礎情報を用いて作成されております。

半導体・部品テストシステム事業部門は、半導体・電子部品産業においてテストシステム製品を顧客に提供することを事業としております。この事業部門は、SoC半導体デバイス向けのSoCテスト・システム、メモリ半導体デバイス向けのメモリ・テスト・システムなどの製品群を事業内容としております。

メカトロニクス関連事業部門は、半導体デバイスをハンドリングするメカトロニクス応用製品のテスト・ハンドラ、被測定物とのインタフェースであるデバイス・インタフェースおよびナノテクノロジー関連の製品群を事業内容としております。

サービス他部門の内容は、上記の事業に関連した総合的な顧客ソリューションの提供、半導体やモジュールのシステムレベルテストのソリューション、サポート・サービス、消耗品販売、中古販売および装置リース事業等で構成されております。

2. 報告セグメントに関する情報

当社グループは、株式報酬費用調整前営業利益（△損失）をマネジメントによる事業別セグメントの評価等に使用しております。

株式報酬費用は、業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬の費用であります。

報告セグメントの利益（△損失）は、株式報酬費用調整前営業利益（△損失）をベースとしております。セグメント間の売上高は市場実勢価格に基づいております。

前第1四半期連結累計期間（自 2023年4月1日 至 2023年6月30日）

（単位：百万円）

	半導体・部品 テスト システム事業	メカトロ ニクス関連 事業	サービス他	消去または 全社	連結
売上高					
外部顧客への売上高	70,547	8,544	22,160	—	101,251
セグメント間の売上高	—	—	—	—	—
合計	70,547	8,544	22,160	—	101,251
セグメント利益（△損失）（調整前営業利益（△損失））	18,332	3	△634	△2,884	14,817
（調整）株式報酬費用	—	—	—	—	△548
営業利益	—	—	—	—	14,269
金融収益	—	—	—	—	294
金融費用	—	—	—	—	△1,602
税引前四半期利益	—	—	—	—	12,961

当第1四半期連結累計期間（自 2024年4月1日 至 2024年6月30日）

（単位：百万円）

	半導体・部品 テスト システム事業	メカトロ ニクス関連 事業	サービス他	消去または 全社	連結
売上高					
外部顧客への売上高	101,108	14,261	23,356	—	138,725
セグメント間の売上高	—	—	—	—	—
合計	101,108	14,261	23,356	—	138,725
セグメント利益（△損失）（調整前営業利益（△損失））	32,511	2,467	1,367	△4,514	31,831
（調整）株式報酬費用	—	—	—	—	△506
営業利益	—	—	—	—	31,325
金融収益	—	—	—	—	1,281
金融費用	—	—	—	—	△676
税引前四半期利益	—	—	—	—	31,930

（注）全社に含まれるセグメント利益（△損失）への調整は、主として全社一般管理費および事業セグメントに割り当てられていない基礎的研究活動に関連する研究開発費であります。

2024年7月31日
株式会社アドバンテスト

2024年度第1四半期 決算（連結）の概要

1. 損益

(単位：億円)

	2023年度実績				2024年度実績			2024年度業績予想	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期比	前期比	通期	前年度比
売上高	1,013	1,162	1,332	1,358	1,387	37.0%	2.2%	(5,250) 6,000	23.3%
売上原価	△503	△582	△658	△662	△618	22.9%	△6.5%	—	—
販売費および一般管理費	△369	△402	△407	△412	△456	23.4%	10.6%	—	—
その他の収益・費用	2	32	1	△89	0	—	△99.6%	—	—
営業利益 (売上高比率)	143 (14.1%)	210 (18.1%)	268 (20.1%)	195 (14.4%)	313 (22.6%)	2.2倍	60.4%	(900) 1,380 (23.0%)	69.1%
金融収益・金融費用	△13	△7	△5	△9	6	—	—	—	—
税引前当期利益 (売上高比率)	130 (12.8%)	203 (17.5%)	263 (19.7%)	186 (13.7%)	319 (23.0%)	2.5倍	71.6%	(890) 1,385 (23.1%)	77.2%
法人所得税費用	△38	△36	△51	△34	△80	2.1倍	2.3倍	—	—
当期利益 (売上高比率)	92 (9.1%)	167 (14.4%)	212 (15.9%)	152 (11.2%)	239 (17.2%)	2.6倍	57.6%	(670) 1,050 (17.5%)	68.6%

(注) 上段()の数値は、2024年4月26日発表時の予想であります。

2. 財政状態

(単位：億円)

	2023年度実績				2024年度実績	
	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	前年度末比
総資産	6,077	6,308	6,350	6,712	7,232	7.7%
親会社の所有者に 帰属する持分合計	3,836	4,018	4,022	4,312	4,569	6.0%
親会社所有者帰属持分比率	63.1%	63.7%	63.3%	64.2%	63.2%	—

3. 配当の状況

(単位：円)

	2023年度実績			2024年度予想		
	中間	期末	年間	中間	期末	年間
1株当たり配当金	65.00	18.00	—	19.00	未定	未定

(注) 1. 現時点では2024年度の期末配当については未定です。今後の業績等を勘案し、予想が可能となった時点で速やかに開示する予定です。

2. 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。

2023年度の中間配当については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

2023年度の年間配当については、株式分割の実施により単純合算ができないため、表示しておりません。

なお、株式分割を考慮しない場合の年間配当金は137円、株式分割を考慮する場合の年間配当金は34.25円です。